

## <半導体パッケージ基板ガラス・サブストレートの動向> 240322 版

昨年5月、JPCAは「プリント配線板技術ロードマップ」を発行し、10年先のプリント配線板のあるべき姿についての仮説を提示するとともに、今後の技術、市場、および応用製品動向について解説しました。その後9月に開催した半導体パッケージ用ガラス・サブストレートのセミナーには、JPCA、JEITA、およびJIEP会員だけでなく多方面からの参加をいただき、高い評価をいただきました。

またセミナー後にはIntelから次世代パッケージとしてのガラス・サブストレートの発表があり、技術ロードマップの予測が正しかったことが証明されるとともに、関連する業界は盛り上がりを見せています。しかし詳細な情報は開示されておらず、今後のビジネスのため仮説に基づく検討が必要になって参りました。

今回のセミナーでは、まずパネルディスカッション **募集終了** などを討議します。さらに、ガラス・サブストレート実現のための要素技術の動向について、ガラスへの穴あけ加工、メタライズなどの詳細を専門家の方々から解説して頂きます。そして、理解の促進とネットワーク形成の一助として技術交流会を開催しますので、是非とも会場にお越し下さい。



### 募集要項

日時：2024年3月25日（月）10:00～12:00(第一部)、13:00～17:00(第二部)

会場：回路会館地下1階会議室（東京都杉並区西荻北3-12-2）アクセス：[https://jpca.jp/about\\_jpca/access/](https://jpca.jp/about_jpca/access/)

主催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

**通常2日分の内容を1日に凝縮！**

●**第一部プログラム**（時間は質疑時間を含みます。内容については変更する場合があります。）

第一部：ガラス・サブストレート実現可能性について

10:00-12:00	<b>パネルディスカッション</b> “ガラス・サブストレート”についての、技術・要素技術面から今後の可能性を討議致します パネリスト：宇都宮 久修氏（インターコネクションテクノロジーズ(株)）、飯長 裕氏（OKIサーキットテクノロジー(株)）、加藤 凡典氏（(有)イー・アイ・ティ）、酒井 泰治氏（FICT(株)）、横内 貴志男氏（関東学院大学）、城野 啓太氏（(株)レゾナック）
-------------	---

●**第二部プログラム**（時間は質疑時間5分を含みます。内容については変更する場合があります。）

第二部：ガラス・サブストレート実現のための要素技術

13:00-14:00	<b>要素技術の総論；ガラス材料を含む</b> 宇都宮 久修 氏（インターコネクション・テクノロジーズ(株)）
14:05-14:35	<b>穴あけ技術</b> 上館 寛之 氏（LPKF Laser & Electronics(株)）
14:35-14:50	休憩
14:50-15:20	<b>シード層メタライズ技術</b> 上山 浩幸 氏（(株)DTUS）
15:25-15:55	<b>メタライズ技術</b> 西中山 宏 氏（大和電機工業(株)）
15:55-16:10	休憩
16:10-16:40	<b>半導体の最新市場動向</b> みずほ証券(株) 山本 義継 氏
16:45-17:00	事務局連絡 他 ※アンケート記入

●**技術交流会** ※理解の促進とネットワーク形成のために是非ご活用ください

17時半～19半時頃	飲食店での開催（会費制）
------------	--------------

## ●参加要項

定員：先着 オンライン 250名 会場 50名 (会場定員に達した場合、オンラインに変更をお願いさせていただきます)

※書籍の購入は必須です。お持ちでない方にはセット料金(下表)でご提供します 別途、単独でのご購入も可能です

※書籍情報：[プリント配線板技術ロードマップ 2023 年度版](#)

	書籍未購入の方 (聴講料とセット)	聴講のみ/ 書籍購入済
JPCA/ JEITA/ JIEP 会員様	税込 35,000 円	税込 15,000 円
上記非会員様	税込 65,000 円	税込 25,000 円

※技術交流会ご参加の方には、上記金額に加え、5,000 円の追加となります (技術交流会は満席となりました)

※同一企業で複数名でのセミナーご参加等でも、ご参加者全員の聴講お申し込みは必要になります。  
但し会議室等で集合してご聴講の場合は、最低 1 名様分を書籍未購入での金額でお申し込み下さい。

## ●申込方法

以下の URL で表示されるフォームを用いて、3月21日(木)迄に電子申し込みをお願い致します。(Google form 使用)

### [3/25 ロードマップセミナーお申込み様式](#)

上記電子フォームでの申し込みが使用できない場合は本文書に添付の別紙申込書に必要事項をご入力の上、電子メールで事務局宛にお申し込み下さい。なおお申し込み後順次、ご担当者様宛にメールにてご請求書をお送りさせていただきますが、お申込後のキャンセルはお受けできかねる点をご留意いただきたくお願い致します。万一、お申込み後にご都合が悪くなった場合には、代理の方のご出席等を前提にご調整をお願い致します

## ●参加方法

- ・会場でご参加の方は、回路会館地下 1F 会議室に直接お越しください (名刺をご持参ください)。
- ・オンラインでご参加の方はブロードバンドなど高速通信が可能な環境でご視聴ください。また PC での視聴をお勧めします。

## ●補足

- ・視聴用 URL、並びに書籍のダウンロード URL の発行は、開催数日前を目処に順次ご案内させていただきます。  
請求書の発行タイミングと前後する場合がございますが、その点はご了承をお願い致します。
- ・オンライン視聴用 URL はオンラインでご参加の方のみのご利用としていただきます (会場参加者の利用はご遠慮いただきます)
- ・書籍のダウンロード URL は、お申し込みいただいた方のみがダウンロードできる設定となりますのでご注意ください。
- ・ダウンロードいただいた書籍は同一の PC で共有いただく限りにおいては複数の方での閲覧が可能です。
- ・ご受講申込者と別の方が受講される場合や、参加方法の変更を希望する場合は、事前に事務局へご連絡ください。
- ・講師の意向により投影資料の配布は致しかねます。
- ・オンラインでの使用アプリケーションは Zoom ウェビナーです。初めて使われる方は、PC へアプリケーションをダウンロードいただき、事前にテスト用ページ (<https://zoom.us/test>) 等で接続環境のご確認をお願い致します。
- ・講師の意向により投影資料の配布は致しかねます。
- ・技術交流会会場等の詳細は日程が近づいてからのご案内を予定しております。

●他お問い合わせ 一般社団法人日本電子回路工業会 ロードマップセミナー係 藤木/青木 (std2@jpca.org) TEL : 03-5310-2020

※申込様式：電子フォームでの申込ができない場合にご使用ください

2024年 月 日

一般社団法人日本電子回路工業会 藤木 行

E-mail : [std2@jpca.org](mailto:std2@jpca.org)

### ロードマップセミナー(3月25日開催)申込書

貴社名	
会員区分	該当する区分にチェックをお入れください <input type="checkbox"/> JPCA会員 <input type="checkbox"/> JIEP会員 <input type="checkbox"/> JEITA会員 <input type="checkbox"/> 左記への非会員(一般) ※上記所属が不明な方にはお手数をおかけしますが、各団体へお問い合わせの上、ご確認ください。 ※JIEP個人会員の方は会員番号をご記入ください→ ( ) (JIEP問合せ先) <a href="https://web.jiep.or.jp/inquiry.html">https://web.jiep.or.jp/inquiry.html</a>
受講者名 /申込者名	フリガナ: 受講者ご氏名: ※受講者と申込者が異なる場合は以下もご記載ください 申込者ご氏名:
ご連絡先 (申込者)	〒 TEL : FAX : E-mail :
受講者の所属/役職	
参加方法	<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> オンライン
申込対象	<input type="checkbox"/> 講演のみ <input type="checkbox"/> 技術交流会参加(会場参加の方対象)
書籍購入状況	<input type="checkbox"/> 未 <input type="checkbox"/> 済 ※セミナーご参加には書籍の購入、所有が聴講申込の前提となります
セミナーをお知りになった機会	<input type="checkbox"/> JPCAのメルマガ <input type="checkbox"/> JPCA HP公開情報 <input type="checkbox"/> ご所属団体からの発信情報 <input type="checkbox"/> その他(自由記述) ( )
s通信欄	(ご参加にあたり補足等あればご記入ください)

※参加費用の請求書および書籍ダウンロードアドレスは上記ご担当者様宛にお送りします。

※E-mail アドレスは正確にご記入ください。ダウンロード版データ配信の際に必要となります。

**セミナー参加費用:** ※書籍の購入は必須となります

	書籍未購入の方(聴講料とセット)	書籍購入済(聴講料のみ)
JPCA/JEITA/JIEP 会員様	税込 35,000 円	税込 15,000 円
上記非会員様	税込 65,000 円	税込 25,000 円

※技術交流会ご参加の方には、上記金額に加え、5,000 円の追加となります

※同一企業で複数名でのセミナーご参加等でも、ご参加者全員の聴講お申し込みが必要となります。

但し会議室等で集合してご聴講の場合は、最低1名様分を書籍未購入での金額でお申込み下さい。

(以下をご確認、チェックの上、事務局までお申し込みください)

- 参加状況に応じた適切な区分選択(会員の該否、書籍所有の該否)を行っています
- 申込後のキャンセルはできないことを理解しました

申込締切: 2024年3月21日(木)